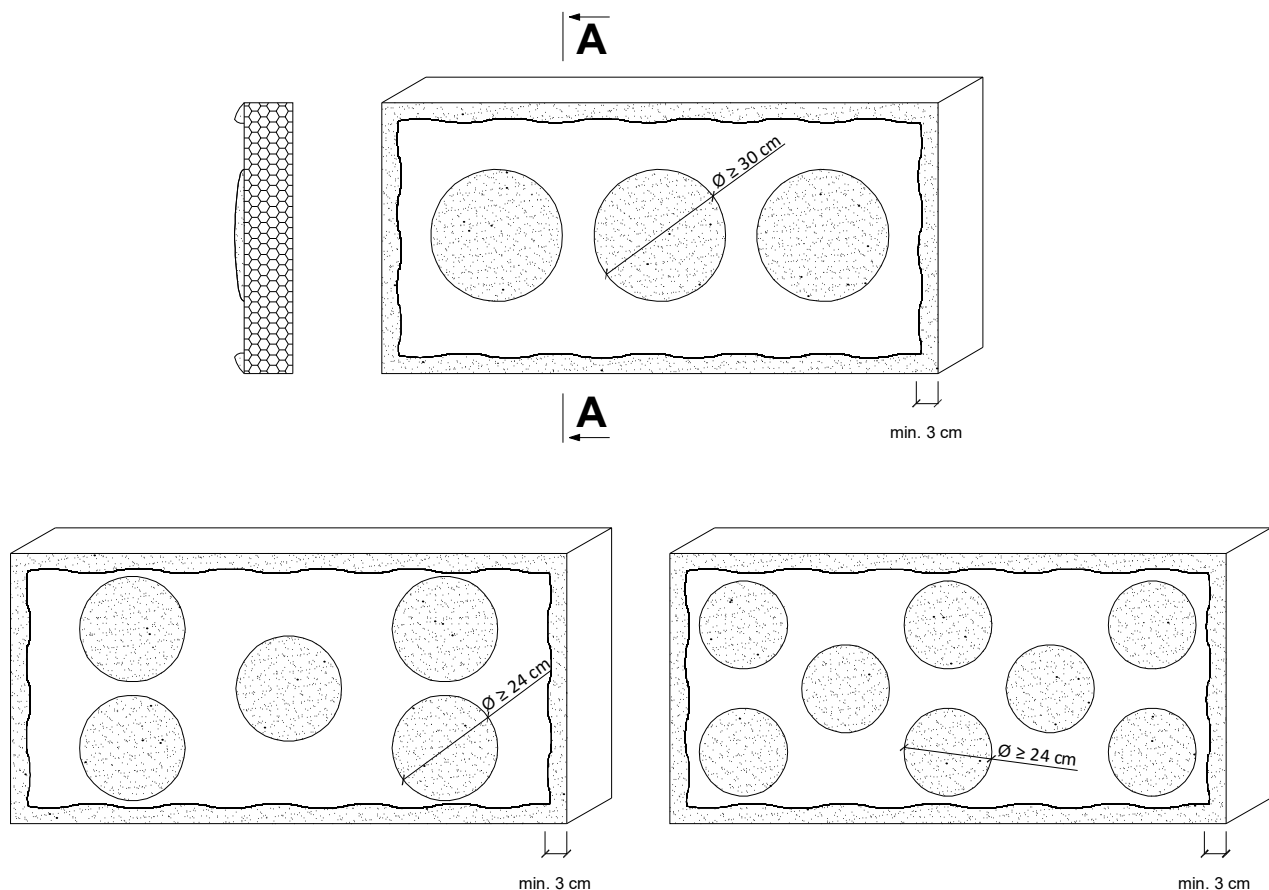
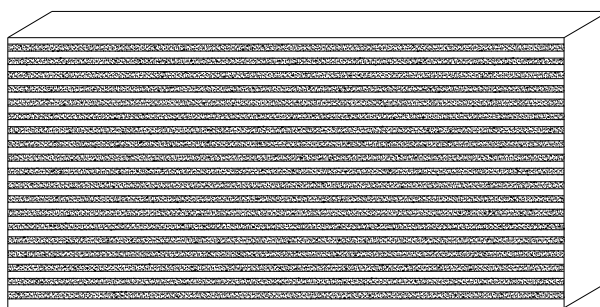


Metoda "pasmowo-punktowa"



Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca po dociśnięciu do podłoża powinna zapewniać min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.

Metoda grzebieniowa



W przypadku równych i gładkich podłoży płyty termoizolacyjne można kleić tzw. metodą grzebieniową przy użyciu pacy zębatej (zęby 10-12 mm).

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Nazwa schematu
Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej
BOLIX na płytach XPS 60 x 125 cm

Nr schematu
1.13.2

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach technicznych BOLIX.

Data wykonania schematu
01.2017

BOLIX[®]

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl